

2018 年发表文章(共 XX 篇,英文 XX 篇)

2017 年发表文章(共 40 篇,英文 25 篇)

- (1) Guoyun Zhou, Xiaolan Xua, Shouxu Wang, Xuemei He, Wei He, , Xinhong Su, Ching Ping Wong, Surface Grafting of Epoxy Polymer on CB to Improve Its Dispersion to Be the Filler of Resistive Ink for PCB,Results in Physics (1.337,中科院分区 3 区), 2017 (In Press)
- (2) Yunjie Qin, Xinhong Su,Yongshuan Hu,Yuanming Chen, Xiao Li, Xuemei He, Wei He, Huaiwu Zhang.Manufacture of HDI printed circuit board with Rogers base material.14th Electronic Circuits World Convention , KINTEX, South Korea April 25~27, 2017
- (3) CHEN Shijin, CHEN Yuanming, HU Zhiqiang, WANG Shouxu, HE Wei, ZHOU Guoyun, CHEN Bei. Application of ultra-thin technologies for manufacturing HDI printed circuit board. 14th Electronic Circuits World Convention , KINTEX, South Korea April 25~27, 2017
- (4) Jing Xiang, Chong Wang, Yuanming Chen, Shouxu Wang, Yan Hong, Huaiwu Zhang , Lijun Gongb, Wei He . Improving wettability of photo-resistive film surface with plasma surface modification for coplanar copper pillar plating of IC substrates. Applied Surface Science. 411 (2017) 82–90
- (5) Li Zheng, Yuanming Chen, Xuemei He, Shouxu Wang, Huaiwu Zhang, Lijun Gong, Bei Chen, Wei He. Dropping simulation induced by BGA position in printed circuit board for optical module application, 2nd International Conference on Electrical and Electronics: Techniques and Applications, 2017: 219-224.
- (6) Jintian Wu, Lingling Wang, Peidong Liu, Yuanjie Liu, Bei Chen,Zhijia Taoand Wei He. Electrochemical Investigation of Thiourea as Corrosion Inhibitor for Copper in Acidic Solution. Advances in Energy Science and Environment Engineering Proceeding in 2017 International Workshop on Advances in Energy Science and Environment Engineering (AESEE 2017),Hang Zhou, China 7-9 April 2017
- (7) Jianhui Lina,Chong Wang, b,Shouxu Wang,Yuanming Chen,Wei He, b, *,Tan Zeb,Bei Chen Preparation of rimose NiZnP electrode for hydrogen evolution reaction in alkaline medium by electroless and H2SO4 etching. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 719(30): 376-392. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.05.194
- (8) Yunjie Qin, Xinhong Su,Yongshuan Hu,Yuanming Chen, Xiao Li, Xuemei He, Wei He, Huaiwu Zhang.Manufacture of HDI printed circuit board with Rogers base material.14th Electronic Circuits World Convention , KINTEX, South Korea April 25~27, 2017
- (9) LinxianJi, HexianNie, ShidongSu,ShouxuWang, YuanmingChen, HuaiwuZhang, BeiChen, LiyangChen, Kehua Aid, Qinghua Li, Wei He.Effect of additives on copper electrodeposition for microvia filling.14th Electronic Circuits World Convention , KINTEX, South Korea April 25~27, 2017
- (10) CHEN Shijin, CHEN Yuanming, HU Zhiqiang, WANG Shouxu, HE Wei, ZHOU Guoyun, CHEN Bei. Application of ultra-thin technologies for manufacturing HDI printed circuit board. 14th Electronic Circuits World Convention , KINTEX, South Korea April 25~27, 2017
- (11) C. Wong, N. Wen, G. Y. Zhou, S. X. Wang, W. He, X. H. Su, Y. S. Hu. Incorporation of Tin on Copper Clad Laminate to Increase the Interface Adhesion for Signal Loss Reduction of High-frequency PCB Lamination[J]. Applied Surface Science 422 (2017) 738–744.
- (12) Li Zheng, Chong Wang, Jing Li, Yuanming Chen, Yongqiang Li, Yongqiang Peng, Dingjun Xiao, Ze Tan, Wei He.investigation of benzoquinone as a new type of cu electroplating additive , IMPACT 2017, Taiwan ,Oct,25-26
- (13) LiPing Jia, Yuanming Chen,Yongqiang Li, Shouxu Wang, Guoyun Zhou, Huaiwu Zhang, Xinhong Su, Yongqiang Peng, Wei He.ELECTROLESS NICKEL PLATING ON FINE PITCHES OF CERAMIC

SUBSTRATE .IMPACT 2017, Taiwan ,Oct,25-26

- (14) Yuanming Chen, Qingyao Gao, Xuemei He, Kai Zhu, Shouxu Wang*, Chong Wang, Wei He, Guoyun Zhou, Huaiwu Zhang. Enhancing adhesion performance of no-flow prepreg to form multilayer structure of printed circuit boards with plasma-induced surface modification. *Surface & Coatings Technology*. 2018,333:24~31.
- (15) Yong Jun Li, Yan Hong, Qian Peng, Jiannian Yao, and Yong Sheng Zhao. -Dependent Exciton-Plasmon Coupling in Embedded Organic/Metal Nanowire Heterostructures. *ACS Nano*, 2017, 11 (10), pp 10106–10112
- (16) Li Zheng, Yuanming Chen, Xuemei He, Shouxu Wang, Huaiwu Zhang, Lijun Gong, Bei Chen, Wei He. Dropping simulation induced by BGA position in printed circuit board for optical module application, 2nd International Conference on Electrical and Electronics: Techniques and Applications, 2017: 219-224.
- (17) Xuemei He, Tao Shen, Shouxu Wang, Yuanming Chen, *, Huaiwu Zhang, Lijun Gong, Bei Chen, Wei He. Preparation of PMMA/PGMA blend to apply for metallographic cross section of printed circuit board. 3rd Annual International Conference on Advanced Material Engineering (AME 2017)
- (18) Jintian Wu, Lingling Wang, Peidong Liu, Yuanjie Liu, Bei Chen, Zhihua Tao and Wei He. Electrochemical Investigation of Thiourea as Corrosion Inhibitor for Copper in Acidic Solution. *Advances in Energy Science and Environment Engineering Proceeding in 2017 International Workshop on Advances in Energy Science and Environment Engineering (AESEE 2017)*, Hang Zhou, China 7-9 April 2017
- (19) Jianhui Lin, Chong Wang, Shouxu Wang, Yuanming Chen, Wei He, Tan Ze, Bei Chen. Preparation of rimose NiZnP electrode for hydrogen evolution reaction in alkaline medium by electroless and H₂SO₄ etching[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2017, 719(30): 376-392.
- (20) Linxian Ji, Hexian Nie, Shidong Su, Shouxu Wang, Yuanming Chen, Huaiwu Zhang, Bei Chen, Liyang Chen, Kehua Aid, Qinghua Li, Wei He. Effect of additives on copper electrodeposition for microvia filling. 14th Electronic Circuits World Convention, KINTEX, South Korea April 25~27, 2017
- (21) C. Wong, N. Wen, G. Y. Zhou, S. X. Wang, W. He, X. H. Su, Y. S. Hu. Incorporation of Tin on Copper Clad Laminate to Increase the Interface Adhesion for Signal Loss Reduction of High-frequency PCB Lamination[J]. *Applied Surface Science* 422 (2017) 738–744.
- (22) Jintian Wu¹, Lingling Wang¹, Peidong Liu¹, Yuanjie Liu¹, Bei Chen³, Zhihua Tao^{1,2a}) and Wei He. Electrochemical Investigation of Thiourea as Corrosion Inhibitor for Copper in Acidic Solution. *Advances in Energy Science and Environment Engineering AIP Conf. Proc.* 1829, 020047-1–020047-4; doi: 10.1063/1.4979779 Published by AIP Publishing. 978-0-7354-1497-6/\$30.00
- (23) Li Zheng, Chong Wang, Jing Li, Yuanming Chen, Yongqiang Li, Yongqiang Peng, Dingjun Xiao, Ze Tan, Wei He. investigation of benzoquinone as a new type of Cu electroplating additive, *IMPACT 2017*
- (24) LiPing Jia, Yuanming Chen, Yongqiang Li, Shouxu Wang, Guoyun Zhou, Huaiwu Zhang, Xinhong Su, Yongqiang Peng, Wei He. ELECTROLESS NICKEL PLATING ON FINE PITCHES OF CERAMIC SUBSTRATE. *IMPACT 2017, Taiwan ,Oct,25-26*
- (25) G. Y. Zhou, X. L. Xu, S. X. Wang, X. M. He, W. He, X. H. Su, C. P. Wong, Surface grafting of epoxy polymer on CB to improve its dispersion to be the filler of resistive ink for PCB[J]. *Results in Physics* 7 (2017) 1870–1877
- (26) 贾莉萍, 陈苑明, 周国云, 陈先明, 罗, 苏新虹, 胡永栓, 张怀武, 何为. 低温条件下化学镀镍的研究. 2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20-21 日, 广东东莞.(大会报告)

- (27) 何迪 周国云 陈苑明 何为 王守绪陈世金 徐缓.印制电路板埋嵌电感化学镀 Ni 基磁芯材料研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20-21 日, 广东东莞.(大会报告)
- (28) 郑莉,王翀,王守绪,何为,陈世金,陈际达,张胜涛.含 N+杂环基团整平剂对通孔电镀效果的影响研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20-21 日, 广东东莞.(大会报告)
- (29) 曾亮,陈苑明,王守绪,何为, 陈世金,陈际达,张胜涛.3D 铜柱互连阵列对封装基板热传导的仿真研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20-21 日, 广东东莞.(大会报告)
- (30) 贾莉萍, 陈苑明, 周国云, 陈先明, 罗, 苏新虹, 胡永栓, 张怀武, 何为.低温条件下化学镀镍的研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20 日, 广东东莞.(大会报告)
- (31) 何迪 周国云 陈苑明 何为 王守绪陈世金 徐缓.印制电路板埋嵌电感化学镀 Ni 基磁芯材料研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20 日, 广东东莞.(大会报告)
- (32) 熊艳平, 程骄, 梁坤, 程东向, 王翀, 刘彬云, 何为, 陈世金.挠性印制电路板通孔电镀铜抑制剂和电镀配方的研究及应用.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20 日, 广东东莞.(大会报告)
- (33) 郑莉,王翀,王守绪,何为,陈世金,陈际达,张胜涛.含 N+杂环基团整平剂对通孔电镀效果的影响研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20 日, 广东东莞.(大会报告)
- (34) 贾莉萍、陈先明、罗明、苏新虹、胡永栓、张怀武、何为.PCB 表面化学镍的无钯活化方法研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20 日, 广东东莞
- (35) 曾亮, 陈苑明, 王守绪, 何为, 周国云, 陈世金, 陈际达, 张胜涛.3D 铜柱互连阵列对封装基板热传导的仿真研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20 日, 广东东莞.(大会报告)
- (36) 贾莉萍, 陈苑明, 周国云, 陈先明, 罗, 苏新虹, 胡永栓, 张怀武, 何为.低温条件下化学镀镍的研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20-21 日, 广东东莞.(大会报告)
- (37) 胡志强, 陈苑明, 王守绪, 张怀武, 艾克华, 李清华, 王青云, 何为.以镍为种子层的半加成工艺研究.2017 春季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 3 月 8 日, 上海(大会报告)
- (38) 熊艳平, 程骄, 梁坤, 程东向, 王翀, 何为.挠性印制电路板通孔电镀铜抑制剂和电镀配方的研究及应用.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20-21 日, 广东东莞.(大会报告)
- (39) 贾莉萍、陈先明、罗明、苏新虹、胡永栓、张怀武、何为.PCB 表面化学镍的无钯活化方法研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20 日, 广东东莞
- (40) 贾莉萍, 陈苑明, 周国云, 陈先明, 罗, 苏新虹, 胡永栓, 张怀武, 何为.低温条件下化学镀镍的研究.2017 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2017 年 10 月 20-21 日, 广东东莞.(大会报告)

2017 年之前发表文章(共 298 篇,英文 96 篇)

- (1) Y. Deng, X.H. Su, C. Chen, S.T. Zhang, Y. Jin, W. He. Study on Cyanide-free Immersion Gold Technology of Gold Potassium Citrate. The 12th Electronic Circuits World Convention. The 12th Electronic Circuits World Convention (ECWC12). 2011.11, Taiwan.(大会优秀论文).
- (2) Yi Jin, Zhengqing Chen, Xinhong Su, Yunzhong Huang, Yin Deng, Guoyun Zhou, Wei He. Study on Embedded Capacitor Technology and its Application. The 12th Electronic Circuits World Convention. The 12th Electronic Circuits World Convention (ECWC12). 2011.11, Taiwan.(大会优秀论文).
- (3) Minjie Ning, Wei He, Xianzhong Tang, Zhihua Tao, Xuemei He, Lin Xiang. Research on the Effect of Inorganic Components on Brightener in Horizontal Pulse Plating Solution by Cyclic Voltammetric Stripping Method. International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology Conference(IMPACT Conference 2012). : On OCT 24-25 at Taipei.
- (4) Zhihua Tao, Yuanming Chen, Shouxu Wang, Wei He and Jia Zhang. A Study of Primary Factors Influencing the Properties of Plating Throwing Power for Printed Circuit Boards. Advanced Materials Research Vol. 721 (2013) pp 409-413

- (5) Xinhong Su, Yuanming Chen, Wei He, Shouxu Wang, Zhihua Tao. Research on Manufacturing Process of Buried /Blind Via in HDI Rigid-Flex Board. *Applied Mechanics and Materials* Vols. 365-366 (2013) pp 527-531(EI : 20134316887723)
- (6) Y. Dong, W. He, Y. Chen, Y. Huang, X. Su, Y. Hu. Delamination Prevention of Rigid-flex PCB with Plasma Treatment on Polyimide Film. 13th Electronic Circuits World Convention, Berlin: Offenbach, Nuremberg, Germany, 2014.
- (7) Shouxu Wang, Ting Yang ,Yuanming Chen, Wei He,T Yongsuan Hu and Xinhong Su.he Study of Conductive Paste Per-curing Condition for Press Fit Blind Hole Backplane Technology Applications. *Circuit World*, 2016,42(3):104-109
- (8) Yuanming Chen, Wei He, Guoyun Zhou, Yongsuan Hu, Shouxu Wang and Zhihua Tao. Preparation and thermal effects of polyarylene ether nitrile aluminium nitride composites. *Polymer International*. 2014, 63(3): 546-551
- (9) Yuanming Chen, Wei He*, Xianming Chen, Chong Wang, Zhihua Tao,Shouxu Wang, Guoyun Zhou, Mohamed Moshrefi-Torbatic. Plating Uniformity of Bottom-up Copper Pillars and Patterns for IC Substrates with Additive-assisted Electrodeposition .*Electrochimica Acta*,120,pp293-310,2014
- (10) W. He , H. Cui, Y.Q. M0, S.X. Wang, B. He ,K. Hu, J. Guan, S.L. Liu Y. Wang. Producing Fine Pitch Substrate of COF by Semi-Additive Process and Pulse-Reverse Plating of Cu. *Transactions of the Institute of Metal Finishing*. 2009VOL 87(1)33-37(SCI 收录 : ISI:000265316300007)
- (11) W. He ; K.Hu ; J.H .Xu ;X. Z. Tang ;X.D.Zhang ;B. He . Non Linear Regression Analysis of Technological Parameters of the Plasma Desmear Process for Rigid-Flex PCB. *Journal of Applied Surface Finishing*.2007 , vol2(3)
- (12) Wang Yang,He Wei,He Bo,Long Hairong,Liu Meicai. Research on crucial manufacturing Process of rigid-flex PCB. *Journal of Electronic Science and Technology of China*.4(1) , 2006
- (13) W. He , Z.X. Liu, W.Hua Z.X. Yuan,K.Hu ,B.He ,X.D.Zhang, J.H.Xu. Characterization of electrodeposited cuprous oxide by the magnetic field inducing. *Plating and Surface Finishing*..2008
- (14) Zhao Li, He Wei, Wang Shou-Xu, Wu Xiang-Hao, He Bo, & Zhang Xuan-Dong. Research on the Process of Buried/blind via in HDI Rigid-flex board.3rd International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology (IMPACT) Conference and 10th EMAP Joint Conference 2008, 10,TAIWAN
- (15) Wang Yang, He Wei, Mo Yun-Qi,Wang Shou-Xu, Wu Xiang-Hao, He Bo, Zhang Xuan-Dong . Failure Analysis on the Chip Capacitor. 2009 IEEE Circuits and Systems International Conference on Testing and Diagnosis April 28-29, 2009, Chengdu, China(EI: 20093812320157)
- (16) Mo Yunqi, He Wei, Wang Shou-Xu, Wu Xiang-Hao, He Bo, Zhang Xuan-Dong. Failure Analysis on the BGA Solder. 2009 IEEE Circuits and Systems International Conference on Testing and Diagnosis April 28-29, 2009, Chengdu, China(EI: 20093812320156)
- (17) Yang ying ,Wang Shou-Xu, He Wei , Hu Ke, He Bo, Mo Yun-Qi. Preparation of Ultra-fine Copper Powder and Its Application in Manufacturing Conductive Lines by Printed Electronics Technology. International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices, 2009,9, Chengdu. (EI : 20094912523581)
- (18) Zhou Guoyun, He Wei, Wang Shou-Xu , Hu Ke, He Bo, Mo Yunqi. Systematical Research of Plasma Desmear Based on Analysis of Uniform Design for Rigid-flex Board. IEEE Meeting, IMPACT 2009,10,Taiwan
- (19) Guoyun Zhou, Wei He, Shouxu Wang, Yunqi Mo, Ke Hu, Bo He. A Novel Nitric Acid Etchant and Its Application in Manufacturing Fine Lines for PCB. *IEEE Transactions on Electronics Packing Manufacturing*, VOL. 33, NO. 1, JANUARY 2010((SCI 收录 UT ISI: 00027356640003)

- (20) Chen Yuanming, He Wei, Zhou Guoyun , He Xuemei , He Bo, Mo Yunqi, Zhou Hua. Compaction Uniformity and Environmental Adaptability for RFID Antenna. International Conference on Anti-counterfeiting, Security, and Identification ((2010ASID,IEEE, Chengdu .2010.7)(EI : 20104113279112)
- (21) Faming Long ,Wei He, Yuanming Chen, et al. Application of Ultraviolet Laser in High Density Interconnection Micro Blind Via. 2010 5th International Microsystems Packaging Assembly and Circuits Technology Conference (IMPACT). Taipei:TPCA,2010:AS007-1(IEEE 收录, ISSN : 2150-5934)
- (22) Yu xiaofei, He Wei, Wang Shouxu , Mo Yunqi, Hu Ke, He Bo.Research of etching blind hole and desmear with plasma.IMPACT Conference 2011 International 3D IC Conference ,October, 2011,Taiwan
- (23) Yuxin Huang, Wei He ,Zhihua Tao ,Huan Xv,Xv Luo. CO2 Laser Induced Blind-via for Direct Electroplating. International Conference on Frontiers of Mechanical Engineering,Materials and Energy(ICFMEME 2012), December 20-21, 2012,Beijing, China
- (24) Youzuo Hu ,Wei He,Weidong Xue,Yuxing Huang Huan Xu WenQu Lv.Adjustment of CO2-laser parameters during drilling blind vias for HDI PCB” ;2012International Conference on on Computer, Electrical, Electronic, Control and Mechanical Engineering(CEECM2012);December 16-18, 2012, Chongqing, China
- (25) Youzuo Hu ,Wei He ,Weidong Xue ,Yuxing Huang Huan Xu WenQu Lv.Reliability of BGA under Thermal Testing ; IMPACT Conference 2012,Taiwan,from October 24 to 26;
- (26) S. Chen, W. Hu, Z. Li, H. Deng, X. Li, J. Chen. Study on Registration Accuracy for Any Layer HDI Board. 13th Electronic Circuits World Convention, Berlin: Offenbach, Nuremberg, Germany, 2014.
- (27) Yuanming Chen, Xing Gao, Jinling Wang, Wei He, Vadim V. Silberschmidt, Shouxu Wang, Zhihua Tao, Huan Xu. Properties and Application of Polyimide-based Composites by Blending Surface Functionalized Boron Nitride Nanoplates. Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132, 41889
- (28) Xiaowei Li, Jia Liu , Shengtao Zhang ,Wei He ,Shijin Chen , Zhidan Li ,Jida Chen.Study on process technique of PCBs with ladder conductive lines.Circuit World , Volume 41 · Number 1 · 2015 · 34–40
- (29) Yang X. J., He W., W. S. X., et al. Preparation and properties of a novel electrically conductive adhesive using a composite of silver nanorods, silver nanoparticles, and modified epoxy resin. Journal of materials science: Materials in electronics, 2012, 23(1):108-114
- (30) Yang X. J., He W., W. S. X., et al. Effect of the different shapes of silver particles in conductive ink on electrical performance and microstructure of the conductive tracks. Journal of materials science: Materials in electronics, Volume 23, Number 11 (2012), 1980-1986, DOI: 10.1007/s10854-012-0691-z
- (31) Yang X. J., He W., W. S. X., et al. Synthesis and characterization of Ag nanorods used for formulating high-performance conducting silver ink. Journal of Experimental Nanoscience, , Volume 9, Issue 6, 2014
- (32) Jun Cheng Zhou, Wei He, Yao Tang, Yong Suan Hu.Synthesis of Well-dispersed Copper Nanoparticles by L-ascorbic Acid in Diethyleneglycol.2012 2nd International Symposium on Chemical Engineering and Material Properties.2012.6,Taiyuan,China
- (33) (Zhou J C, He W, Tang Y, et al. Synthesis of Well-Dispersed Copper Nanoparticles by L-Ascorbic Acid in Diethyleneglycol[J]. Advanced Materials Research, 2012, 549: 378-381. (Accession number: 20124615675582))
- (34) Ji Liu, Li Zheng, HaiBo Gan, Huan Liu, ZhiHua Tao and Wei He. Electrochemical investigation of Cyproconazole as corrosion inhibitor for copper in synthetic seawater. Advanced Materials Research Vol. 763 (2013) pp 23-27
- (35) Zhihua Tao, Shouxu Wang, Linxian Ji, Li Zheng and Wei He. Electrochemical Investigation of the

- Adsorption Behaviour of Guanine on Copper in Acid Medium. *Advanced Materials Research* Vol. 787 (2013) pp 30-34
- (36) Yuanming Chen, Wei He, Guoyun Zhou and Zihua Tao, Yang Wang and Daojun Luo. Failure mechanism of solder bubbles in PCB vias during high-temperature assembly. *Circuit World*. Volume 39 · Number 3 · 2013 · 133–138
- (37) Zihua Tao, Yuanming Chen, Shouxu Wang¹, Wei He and Jia Zhang. A Study of Primary Factors Influencing the Properties of Plating Throwing Power for Printed Circuit Boards. *Advanced Materials Research* Vol. 721 (2013) pp 409-413(EI : 20133516683454)
- (38) Z. Tao , W. He, S. Wang , S. Zhang , G. Zhou. A study of differential polarization curves and thermodynamic properties for mild steel in acidic solution with nitrophenyltriazole derivative. *Corrosion Science*. *Corrosion Science* 60 (2012) 205–213.
- (39) Zihua Tao,* Wei He,* Shouxu Wang, and Guoyun Zhou. Electrochemical Study of Cyproconazole as a Novel Corrosion Inhibitor for Copper in Acidic Solution. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. [dx.doi.org/10.1021/ie402693d](https://doi.org/10.1021/ie402693d) | *Ind. Eng. Chem. Res.* , 52, pp17891–17899, 2013
- (40) Z. Tao, W. He, S. Wang, S. Zhang, and G. Zhou. Adsorption Properties and Inhibition of Mild Steel Corrosion in 0.5 M H₂SO₄ Solution by Some Triazol Compound. *Journal of Materials Engineering and Performance*. (2013) 22:774–781
- (41) Yuanming Chen, Wei He, Guoyun Zhou, Yongsuan Hu, Shouxu Wang and Zihua Tao. Preparation and thermal effects of polyarylene ether nitrile aluminium nitride composites. *Polymer International*. 2014, 63(3): 546-551
- (42) Songsong Li, Wei Hea, Zihua Tao, Shouxu Wang. Electrochemical investigation of Triadimenol as corrosion inhibitor for copper in 0.5mol/L H₂SO₄ solution. *Advanced Materials Research* Vol. 830 (2014) pp 81-85
- (43) G. Y. Zhou, W. He, S. X. Wang, et al.. Fabrication of a novel porous Ni-P thin-film using electroless-plating: Application to embedded thin-film resistor[J]. *Materials Letters*, 2013, 108: 75-78
- (44) G. Y. Zhou, C. Y. Chen, Z. Y. Lin, et al.. Effects of Mn²⁺ on the electrical resistance of electrolessly plated Ni–P thin-film and its application as embedded resistor[J]. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, 2014, 25: 1341–1347
- (45) G. Y. Zhou, C. Y. Chen, L. Y. Li, W. He , et al.. Effect of MnSO₄ on the deposition of electroless nickel phosphorus and its mechanism[J]. *Electrochimica Acta*, 2014, 127C: 276–282
- (46) .G. Y. Zhou, C. Y. Chen, L. Y. Li, et al.. Effects of MnSO₄ on microstructure and electrical resistance properties of electroless ni–p thin–films and its application in embedded resistor inside PCB[J]. *Circuit World*, 2014 ,40(2):45-52
- (47) Y. Tang, W. He, S. Wang, et al. One step synthesis of silver nanowires used in preparation of conductive silver paste. *JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN ELECTRONICS*. 2014(25):2929-2933 , DOI 10.1007/s10854-014-1961-8
- (48) Yao Tang, Wei He, Shouxu Wang, Zihua Tao and Lijuan Cheng. The superiority of silver nanoellipsoids synthesized via a new approach in suppressing the coffee-ring effect during drying and film formation processes. *Nanotechnology* 25 (2014) 125602 (7pp), <http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/25/12/125602>
- (49) Y. Tang, W. He, S. Wang, et al.. New insight into size-controlled synthesis of silver nanoparticles and its superiority in room temperature sinter[J]. *CrystEngComm*, *CrystEngComm*, 2014,16, 4431-4440. DOI: 10.1039/C3CE42439A
- (50) Y. Dong, W. He, Y. Chen, Y. Huang, X. Su, Y. Hu. Delamination Prevention of Rigid-flex PCB with

- Plasma Treatment on Polyimide Film. 13th Electronic Circuits World Convention, Berlin: Offenbach, Nuremberg, Germany, 2014.
- (51) S. Chen, H. Xu, H. Deng, S. Yang, Z. han, J. Jiang, Wei. He. An analysis of the formation mechanism of voids inside the filled blind via by Copper Electroplating for HDI board. 13th Electronic Circuits World Convention, Berlin: Offenbach, Nuremberg, Germany, 2014.
- (52) Yuanming Chen, Wei He*, Xianming Chen, Chong Wang, Zhihua Tao, Shouxu Wang, Guoyun Zhou, Mohamed Moshrefi-Torbatic. Plating Uniformity of Bottom-up Copper Pillars and Patterns for IC Substrates with Additive-assisted Electrodeposition. *Electrochimica Acta*, 120, pp293-310, 2014
- (53) Shouxu Wang, Li Feng, Yuanming Chen, Wei He, Zhihua Tao, Shijin Chen, Huan Xu. UV laser cutting of glass-epoxy material for opening flexible areas of rigid-flex PCB. *Circuit World*, 2014, Vol. 40 Iss. 3: 85-91.
- (54) Yuanming Chen, Jianhui Lin, Tianyang Qiu, Wei He, Vadim V. Silberschmidt, Shouxu Wang, and Ze Tan. Characterization and Application of Aggregated Porous Copper Oxide Flakes for Cupric Source of Copper Electrodeposition. *Materials Letter*, Volume 139, 15 January 2015, Pages 458-461
- (55) Jianhui Lin, Chong Wang, Yuanmin Chen, Wei He, Dingjuna Xiao, Ze Tan. Preparation of Electronic-grade CuO for Copper Electrodeposition of Printed Circuit Board. *Circuit World*, Volume 40 · Number 4 · 2014 · 127-133
- (56) Shouxu Wang, Lijuan Cheng 1*, Wei He, Guoyun Zhou, Ze Tan, Dingjun Xiao. Synthesis of high aspect ratio silver nanowires by hydrothermal method in the presence of CTAB. *Materials Research Innovations (IF 0.473)*, 2015(已录用).
- (57) SHOUXU. WANG, ZHIHUA. TAO, WEI. HE, DINGJUN. XIAO, ZE TAN. Effects of Cyproconazole on Copper Corrosion as an Environmentally Friendly Corrosion Inhibitor in Nitric Acid Solutions. *Asian Journal of Chemistry*, Vol. 27, No. 2 (2015), 0000-0000
- (58) Linxian Ji, Chong Wang, Shouxu Wang, Wei He*, Dingjun Xiao, Ze Tan. Multiphysics Coupling Simulation of RDE for PCB Manufacturing. *Circuit World*, Volume 41 · Number 1 · 2015 · 20-28
- (59) Guoyun Zhou. Wei He, Shouxu Wang, Haixia Fan, John Xiao. Fabrication and Characterization of Embedded Capacitors in PCB using Epoxy/BaTiO₃/PI Capacitor CCL. *JOURNAL OF INTEGRATION TECHNOLOGY*, 2014, 3(6):14-22
- (60) Yuanming Chen, Xing Gao, Jinling Wang, Wei He, Vadim V. Silberschmidt, Shouxu Wang, Zhihua Tao, Huan Xu. Properties and Application of Polyimide-based Composites by Blending Surface Functionalized Boron Nitride Nanoplates. *Journal of Applied Polymer Science*, 2015, 132, 41889
- (61) Chong Wang^{a,b,*}, Lin Xianga, Yuanming Chena, Shouxu Wanga, Dingjun Xiaob, Wei He^{a,b,*}. Study on Brown Oxidation Process with Imidazole Group, Mercapto Group and Heterocyclic Compounds in Printed Circuit Board Industry. *Journal of Adhesion Science and Technology*, Vol. 29, No. 12, 1178-1189, <http://dx.doi.org/10.1080/01694243.2015.1016596>
- (62) Xiaowei Li, Jia Liu, Shengtao Zhang, Wei He, Shijin Chen, Zhidan Li, Jida Chen, "Study on process technique of PCBs with ladder conductive lines", *Circuit World*, 2015, 41(1): 34-40
- (63) Linxian Ji, Shouxu Wang, Chong Wang, Guoqin Chen, Yuanming Chen, Wei He, and Ze Tan. Improved Uniformity of Conformal Through-Hole Copper Electrodeposition by Revision of Plating Cell Configuration. *Journal of The Electrochemical Society*, 162 (12) D575-D583 (2015)
- (64) L.X. Ji, C.Wang, S.X.Wang, W.He, D.J.Xiao. "An electrochemical model for prediction of microvia filling process with accelerator and Suppressor" *Trans IMF*, VOL 94(1).2016
- (65) Linxian Ji, Chong Wang, Shouxu Wang, Kai Zhu, Wei He, and Dingjun Xiao. "Multi-physics Coupling Aid Uniformity Improvement in Pattern Plating" *Circuit World*, *Circuit World*, 2016, 42(2).
- (66) Jia Peng, Yuanming Chen, Chong Wang, Dingjun Xiao, Wei He. Effects of Additives on Filling Blind

- Vias for HDI Manufacture. IMPACT , Taipei,2015,10
- (67) Zhihua Tao, Wei He, Shouxu Wang, Xuemei He, Cheng Jiao, and Dingjun Xiao. Synergistic Effect of Different Additives on Microvia Filling in an Acidic Copper Plating Solution. *Journal of The Electrochemical Society*, 163 (8) D379-D384 (2016)12
- (68) Guoyun Zhou, Yingjie Mao, Chong Wang, Shouxu Wang, Yuanming Chen, Wei He. Fabrication of silver electrically conductive adhesive to apply in through-hole filling for PCB interconnection. *J Mater Sci: Mater Electron*. DOI 10.1007/s10854-016-4955-x, Published online 11 May 2016
- (69) Jianhui Lin , Chong Wang , Shouxu Wang , Yuanming Chen, Wei He , Dingjun Xiao. Initiation electroless nickel plating by atomic hydrogen for PCB final finishing. *Chemical Engineering Journal* 306 (2016) 117–123 (IF 5.31 二区)
- (70) Shouxu Wang, Ting Yang , Yuanming Chen, Wei He, T Yongsuan Hu and Xinhong Su. Study of Conductive Paste Per-curing Condition for Press Fit Blind Hole Backplane Technology Applications. *Circuit World*, 2016, 42(3):104-109
- (71) Zhou G, Xu X, Yang T, et al. Directly electroless-plating NI-P thin-film to fabricate magnetic core of integrated inductor for printed circuit board[C]// China Semiconductor Technology International Conference. 2016:1-3.
- (72) Yuanming Chen , Jiujuan Li , Na Wen , Wei He, et al. Bottom-up copper plating to form stacked interconnection of HDI printed circuit board for optical module application (5th International Meeting on Opto-Electronics Engineering and Materials Research)
- (73) Shouxu Wang , Yunzhao Chen , Li Zheng, et al. Dropping simulation of printed circuit board with BGA soldering assembly for optical module application (已接收 , 未发表)
- (74) Yuanming Chen, Xuemei He, Yue Wu, Xing Gao, Jinling Wang, Wei He, Vadim V. Silberschmidt, Huan Xu. Effects of surface-functionalized aluminum nitride on thermal, electrical and mechanical behaviors of polyarylene ether nitrile-based composites. *Polymer Composites*, 2016, 37(10): 3033-3041.
- (75) Jing Xiang, Chong Wang, Yuanming Chen, Shouxu Wang, Yan Hong, Huaiwu Zhang , Lijun Gong, Wei He . Improving wettability of photo-resistive film surface with plasma surface modification for coplanar copper pillar plating of IC substrates. *Applied Surface Science*. 411 (2017) 82–90
- (76) Shouxu Wang, Yunzhao Chen, Li Zheng, Yuanming Chen , Huaiwu Zhang, Lijun Gong, Bei Chen and Wei He. Dropping Simulation of Printed Circuit Board with BGA Soldering Assembly for Optical Module Application. *Modeling, Simulation and Optimization Technologies and Applications (MSOTA 2016)*, *Advances in Computer Science Research*, volume 58:477-479
- (77) Jiujuan Li, Yuanming Chen, Yongqiang Li, Na Wen, Shouxu Wang, Lijun Gong, Bei Chen², Wei He. Bottom-up copper plating to form stacked interconnection of HDI printed circuit board for optical module application. 4th International Conference on Machinery, Materials and Information Technology Applications (ICMMITA 2016), *Advances in Computer Science Research*, volume 71:1680-1683
- (78) Zhihua Tao,, Bin.Leng, Chong Wang, Dingjun.Xiao, Ze Tan , Wei He. Electrochemical Investigation Cu Corroals Vols. 556-562 (2014) pp 141-144 (EI 收录)
- (79) D. Xiao, Y. Chen, Z. Tan, D. Yue, B. Liu, S. Wang, W. He, V. V. Silberschmidt. Electronic-grade Copper Oxide Application to Copper Electroplating Solution for Via Metallization of HDI Printed Circuit Boards. 13th Electronic Circuits World Convention, Berlin: Offenbach, Nuremberg, Germany, 2014.
- (80) Li zheng, Ji liu, Zhihua tao, , wei he, , Dingjun Xiao, Ze Tan. Electrochemical Investigation of Myclobutanil as Corrosion Inhibitor for Copper in Acid Medium. *Advanced Materials Research Vols*. 960-961 (2014) pp 229-233. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.960-961.229 (EI 收录)

- (81) Qi Li, Jian Li, Lingtong Hu, Lei Zhu, Xiao Han, ZihuaTaoa and Wei He. Electrochemical study of corrosion inhibition on copper In base electrolyte by 1-Phenyl-3-hydroxy-1,2,4-triazole. *Advanced Materials Research* Vol. 988 (2014) pp 3-7(EI 收录)
- (82) Yuanming Chen , Jianhui Lin , Tianyang Qiu , Wei He , Vadim V. Silberschmidt , Shouxu Wang , and Ze Tan . Characterization and Application of Aggregated Porous Copper Oxide Flakes for Cupric Source of Copper Electrodeposition. *Materials Letter*, Volume 139, 15 January 2015, Pages 458–461(SCI 收录)
- (83) Jianhui Lin , Chong Wang, Yuanmin Chen, Wei He, Dingjuna Xiao, Ze Tan. Preparation of Electronic-grade CuO for Copper Electrodeposition of Printed Circuit Board. *Circuit World*, Volume 40 · Number 4 · 2014 · 127–133(SCI 收录)
- (84) SHOUXU. WANG, ZHIHUA. TAO , WEI. HE , DINGJUN. XIAO, ZE TAN. Effects of Cyproconazole on Copper Corrosion as an Environmentally Friendly Corrosion Inhibitor in Nitric Acid Solutions. *Asian Journal of Chemistry* , Vol. 27, No. 2 (2015), 0000-0000(SCI 收录)
- (85) Linxian Ji,, Chong Wang, Shouxu Wang, Wei He* , Dingjun Xiao, Ze Tanb . Multiphysics Coupling Simulation of RDE for PCB Manufacturing. *Circuit World* , Volume 41 · Number 1 · 2015 · 20–28
- (86) Yuanming Chen ,Shouxu Wang, Wei He ,Vadim V. Silberschmidt b, Ze Tan c. Copper coin-embedded printed circuit board for heat dissipation: manufacture, thermal simulation and reliability. *Circuit World*, *Circuit World*, 2015, 41(2): 55-60
- (87) Chong Wang, Lin Xiang, Yuanming Chen, Shouxu Wang, Dingjun Xiao, Wei He. Study on Brown Oxidation Process with Imidazole Group, Mercapto Group and Heterocyclic Compounds in Printed Circuit Board Industry. *Journal of Adhesion Science and Technology*, Vol. 29, No. 12, 1178–1189, <http://dx.doi.org/10.1080/01694243.2015.1016596>(SCI 收录)
- (88) Linxian Ji,ShouXu Wang, Chong Wang, Guoqin Chen, Yuanming Chen, Wei He, and Ze Tan. Improved Uniformity of Conformal Through-Hole Copper Electrodeposition by Revision of Plating Cell Configuration. *Journal of The Electrochemical Society*, 162 (12) D575-D583 (2015)
- (89) L.X. Ji,C.Wang,S.X.Wang,W.He,D.J.Xiao. “An electrochemical model for prediction of microvia filling process with accelerator and Suppressor” *Trans IMF*, VOL 94(1).2016
- (90) Linxian Ji, Chong Wang, ShouXu Wang,Kai Zhu , Wei He, and DingJun Xiao. “Multi-physics Coupling Aid Uniformity Improvement in Pattern Plating” *circuit world*(录用)
- (91) Jia Peng, Yuanming Chen, Chong Wang, Dingjun Xiao, Wei He. Effects of Additives on Filling Blind Vias for HDI Manufacture. *Mi crosystems, Packagi ng, Assembl y and Ci rcui ts Technology Conference (IMPACT)* , 2015 10th Internati onal. Tai Pei, Pages: 1 69 - 1 72, DOI : 10.1109/IMPACT.2015.7365180 IEEE Conference Publications
- (92) Jia Peng, Yuanming Chen, Chong Wang, Dingjun Xiao, Wei He.Effects of Additives on Filling Blind Vias for HDI Manufacture. *IMPACT* , Taipei,2015,10
- (93) Zihua Tao, Wei He,Shouxu Wang,Xuemei He,Cheng Jiao, and Dingjun Xiao. Synergistic Effect of Different Additives on Microvia Filling in an Acidic Copper Plating Solution. *Journal of The Electrochemical Society*, 163 (8) D379-D384 (2016)12
- (94) Jianhui Lin , Chong Wang , Shouxu Wang , Yuanming Chen, Wei He , Dingjun Xiao.Initiation electroless nickel plating by atomic hydrogen for PCB final finishing. *Chemical Engineering Journal* 306 (2016) 117–123(IF 5.31 二区)
- (95) Shouxu Wang, Ting Yang ,Yuanming Chen, Wei He,T Yongsuan Hu and Xinhong Su.he Study of Conductive Paste Per-curing Condition for Press Fit Blind Hole Backplane Technology Applications. *Circuit World*, 2016,42(3):104-109
- (96) Xuemei He, Wei He, Xinhong Su, Yongshuan Hu, Yong Huang, Minjie Ning, Lijuan Cheng. Study on

- Manufacturing Process of Semi-flex Printed Circuit Board Using Buried Material. International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology Conference(IMPACT Conference 2012). : On OCT 24-25 at Taipei.
- (97) 苏新虹, 邓银, 张胜涛, 何为. 柠檬酸金钾无氰沉金厚度控制研究. 2011 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛. 2011.10, Dongguan.(大会报告).
- (98) 邓银, 张胜涛, 苏新虹, 陈臣, 金轶, 何为. 前处理对化学沉镍金面外观影响的研究. 印制电路信息.2011(11)42-45
- (99) 洪墩华, 苏新虹, 王守绪, 杨颖. 全印制电路用导电聚苯胺的合成与性能研究.印制电路信息.(增刊)2009(10) "462-466
- (100) 吴靖, 王守绪, 张敏, 何为, 苏新虹, 张佳, 朱兴华. 次亚磷酸钠还原化学镀铜工艺研究及展望.印制电路信息.2010(7): 26-29
- (101) 金轶, 何为, 陈正清, 苏新虹, 黄云钟, 周国云, 陈苑明. 提高网印电阻阻值精确度的研究. 2011 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛. 2011.10, Dongguan.(大会报告).
- (102) 金轶, 何为, 苏新虹, 黄云钟, 朱兴华. 多层印制电路板网印内埋电阻技术研究. 电子元件与材料. 2011(30)12: 38-41
- (103) 苏新虹, 周国云, 王守绪, 何为. HDI 印制板二阶微盲填孔的构建研究. 电子元件与材料.2011, 30(10): 72-75
- (104) 胡永栓, 杨小健, 何 为. 用纳米银棒和颗粒制备高导电性油墨. 电子元件与材料, 2012, (31): 40-43
- (105) 朱兴华, 陈苑明, 何为. 印制电路板对信号完整性的影响综述. 印制电路信息.2012(1):21-23
- (106) 李瑛, 陈苑明、何为、黄云中、张佳、赵丽、付志红、刘哲.高频混压多层板散热性能的局限与改善.印制电路信息.2012(1):49-52
- (107) 朱兴华, 何为.矢量网络分析仪在高速 PCB 材料评估中的应用.印制电路信息.2012(6):64-66
- (108) 宁敏洁, 何为, 唐先忠, 何雪梅, 黄勇, 程世刚, 周国云.Study on Plating Filling in Blind Hole by Horizontal Plating for HDI PCB.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2012.11 Guangdong ,Dongguan.
- (109) 李瑛 何为 王守绪 黄云钟 赵巧玲.Improvement Research of Making Defects of Semi-Metalized Groove on RF Power Amplifier PCB.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛 2012.11 Guangdong ,Dongguan.
- (110) 宁敏洁, 何为, 唐先忠, 何雪梅 杨新启, 李亮, 程世刚.Study on the Technology of Simultaneous Through-Hole Metallization and Blind Hole Filled Copper.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2012.11, Guangdong ,Dongguan.
- (111) 于岩, 王守绪, 苏新虹, 何为, 陈苑明.Thermal Stress Simulation of HDI PCB based on Finite Element Analysis of COSMOSWORKS.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2012.11 Guangdong ,Dongguan.
- (112) 何雪梅, 何为, 黄勇, 陈显任, 宁敏洁, 成丽娟.Study on Manufacturing Process of Semi-flex Printed Circuit Board.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2012.11 Guangdong ,Dongguan.
- (113) 胡永栓、周珺成、陆彦辉、何为. 有限元分析层压工艺对挠性板平整性影响.印制电路信息.2012(12):57-59
- (114) 范海霞, 王守绪, 何为, 董颖韬, 胡新星, 苏新虹, 刘丰.双面蚀刻薄介质材料埋容芯板可行性研究, 印制电路信息.2013(5):76-79
- (115) 董颖韬 何为 陈苑明 袁鹏飞黄勇 苏新虹 陈正.2013 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2013,11,20, 广东东莞(大会报告)
- (116) 胡永栓, 唐耀, 周珺成, 室温下抗坏血酸还原法制备纳米铜粉研究[J]. 材料导报, 2013, 27: Z2
- (117) 何彭, 何为, 苏新虹, 朱兴华, 余凯.基于 HFSS 研究 PCB 传输线的信号完整性分析, 2014 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 广东东,2014.11.19-20.

- (118) 王守绪, 胡永栓, 何雪梅, 董颖韬, 苏新虹, 何为.UV 激光控深铣技术在刚挠结合印制电路板中的应用研究.印制电路信息, 2015(6)
- (119) 王守绪, 胡永栓, 苏新虹, 周国云, 董颖韬, 何为.嵌入挠性线路印制电路板中埋入挠性基板区尺寸研究.印制电路信息, 2015(6)
- (120) 杨婷 何为 胡永栓 苏新虹 胡新星 史书汉.超高层数的背板制作中厚板压合过程的影响因素研究.2015 春季国际 PCB 技术/信息论坛,2015, 3, 上海
- (121) 向静, 陈苑明, 何为, 陈先明, 宝玥.电镀前处理对电镀铜柱均匀性改善的研究.2015 春季国际 PCB 技术/信息论坛,2015, 3, 上海
- (122) 向静 陈苑明 何为 胡永栓 宝玥 陈先明.集成电路封装基板整板电镀 3 μ m 薄铜均匀性研究.印制电路信息, 2015(12): 48-52
- (123) 李玖娟、何为、陈苑明、陈先明、占宏斌. 电镀铜均匀性影响因素的分析与优化, 2016 春季国际 PCB 技术/信息论坛论文集, 2016 年 3 月 16, 上海.96-102
- (124) 毛英捷 何为 王守绪 周国云 陈苑明、苏新虹 胡永栓 胡新星 吴世平. 印制电路板铜面处理工艺对高频信号传输的影响研究, 2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集, 2016 年 11 月 3 日, 广东东莞(大会报告).
- (125) 陈苑明, 何雪梅, 张怀武, 何为, 王守绪, 胡永栓, 苏新虹, 李晓. 大数据服务器用盲孔压接背板塞孔互连的研究. 2016 年全国博士后学术论坛: 大数据时代下新型智慧城市及全球展望, 2016: 375-384.
- (126) 何为, 汪洋, 何波, 刘美才, 王慧秀.刚挠板等离子清洗去钻污工艺参数的非线性回归分析.印制电路信息.2006(6)
- (127) 汪洋, 何为, 何波, 龙海荣. 刚挠结合印制电路板的制造工艺和应用.印制电路资讯.2005, No2
- (128) 何为, 李浪涛, 何波, 乔三龙.用正交试验法优化挠性多层板层压工艺参数.印制电路信息.2005(6):53~55
- (129) 何为, 吴志强, 乔三龙.Reason and solution of deformation of material in multi-layer flexible circuits.2005, international PCB technology meeting.
- (130) 何为、汪洋、何波, 龙海荣.The Manufacturing Process and Application of rigid-flex PCB(英文).世界科技研究与发展.2005, 27(3):16~20
- (131) 何为, 吴志强, 乔三龙. 挠性多层板材料变形的原因及解决方法..印制电路信息.2004,No11
- (132) 龙海荣, 何为, 何波.挠性印制板化学镀镍工艺条件的优化.印制电路资讯.2005, No2
- (133) 霍彩虹, 何为, 汪洋, 何波.PI 调整液除去挠性多层板钻污的工艺参数优化.印制电路资讯.2005(4):63~66
- (134) 王慧秀, 何为, 何波.高密度互联(HDI)印制电路板技术现状及发展.世界科技研究与发展, 2(28), 2006
- (135) 王慧秀 何为, 张宣东 徐景浩 何波.微孔沉镀铜前处理研究.印制电路信息, 2006, No12
- (136) 崔浩 何为 张宣东 徐景浩 何波.COF(chip on film)技术现状和发展前景.世界科技研究与发展, 2006, 28(6): 27~33
- (137) 崔浩、何为、张宣东、徐景浩、何波.在挠性印制板中埋入无源和有源元件.印制电路信息.2007, 3
- (138) 王慧秀、刘松伦、张宣东、何波.湿法贴膜在细线路制作中的应用.2007 春季国际 PCB 技术/信息论坛
- (139) 何为、袁正希、崔浩、关键、刘松伦、张宣东、徐景浩、何波.刚挠结合板孔金属化化学沉铜工艺优化.2007 春季国际 PCB 技术/信息论坛(上海)
- (140) 何为 崔浩 张宣东 徐景浩 刘松伦.应用无掩膜印刷术埋入微型聚合物厚膜电阻.印制电路信息, 2007, No5
- (141) 何波, 周国云, 何为, 崔浩, 张宣东, 徐景浩. 在同一薄基材上嵌入电容和电阻提高 PCB 电性能和电路集成度.印制电路信息, 2007, No6
- (142) 张晓杰 何为 崔浩 何波 张宣东 徐景浩 关键.嵌入陶瓷电容器印制电路板的可靠性.印制电路信息, 2007, No8
- (143) 何为 何波 袁正希 徐景浩 扬长生 张宣东. 运用《试验设计方法》提高实践教学质量的研究与实践.中国教育导刊, 2007, 18
- (144) 崔浩 何为 莫云绮何波 张宣东 徐景浩 关键 . COF(chip on film) 30 μ m/30 μ m 精细线路的研制. 2007 秋季国际 PCB 技术/信息论坛(深圳)

- (145) 赵丽 何为 莫芸绮 袁正希,何波 张宣东 徐景浩 关键 付万双.HDI 刚挠结合板中的埋盲孔工艺研究.2007 秋季国际 PCB 技术/信息论坛(深圳)
- (146) 何波 何为 王慧秀 刘松伦 张宣东 徐景浩.超薄铜箔,湿法贴膜在细线路制作中的应用. 印制电路资讯.2007, No6
- (147) 崔浩 何为 周国云何波 张宣东 徐景浩 关键. 用模拟仿真软件预测嵌入元件的热效应. 印制电路信息, 2007, No9
- (148) 赵丽 何为 崔浩 何波 张宣东 徐景浩 关键. 利用埋入电容提高电性能和减少基板尺寸. 印制电路信息, 2007, No11:36-40
- (149) 莫云绮,何为,何波, 张宣东 徐景浩 关键.小尺寸分立器件与聚合物厚膜埋入式电阻在移动电话中的应用比较.印制电路信息, 2008, No2
- (150) 何波 关键 何为 王慧秀 刘松伦 张宣东 徐景浩. COF(chip on film) 30 μ m/30 μ m 精细线路的研制. 印制电路信息, 2008, No3
- (151) 汪洋,莫芸绮,何为,林均秀,徐玉珊,万永东.BGA 焊点失效分析.《印制电路信息》,2008, No7:61-65
- (152) 聂昕、汪洋、莫云绮、何为. 印制电路板的 CAF 生长案例分析与控制对策.《印制电路信息》,2008, No7 : 45-49
- (153) 汪洋、何为、莫云绮、林均秀、徐玉珊. 贴片电容失效分析.电子元器件与材料.2008, 27(11) : 74-77
- (154) 莫芸绮、何为、林均秀、徐玉珊、万永东、吴向好、何波. Production of fine line by Roll to Roll. 2008 中日电子电路秋季大会——秋季国际 PCB 技术,2008.10,深圳
- (155) 赵丽、周国云、何为、林均秀、徐玉珊、万永东、吴向好、何波. Research on laser micro vias processing in rigid and flexible substrate materials.2008 中日电子电路秋季大会——秋季国际 PCB 技术,2008.10,深圳
- (156) 龙发明、周国云、何为、林均秀、徐玉珊、万永东、张宣东、何波. The Development of a New Etchant Applied to PCB Industry. 2008 中日电子电路秋季大会——秋季国际 PCB 技术,2008.10,深圳
- (157) 汪洋、莫芸绮、何为.PCB 镀金层厚度的测定.印制电路资讯.2008(5) : 81-83
- (158) 汪洋、莫芸绮、聂昕、何波、关键、万永东、徐玉珊、吴向好.印制线路板 CAF 失效分析.第八届全国印制电路学术年会.2008.11 北京
- (159) 周国云 何为 王守绪 莫芸绮 何波 张宣东 林均秀 陈国辉. Hydrodynamics Analysis of Spray Etching Fine Conductive Lines in PCB. 2009 春季国际 PCB 技术/信息论坛,2009,10,上海
- (160) 吴向好 何为 赵丽 陈国辉 周国云 何波 莫芸绮. Research on the Process of Crosshatching for Hollowing Board on PI Flexible Substrate. 2009 春季国际 PCB 技术/信息论坛,2009,10,上海
- (161) 倪乾峰 袁正希 何为 赵丽 陈国辉 周国云 何波 莫芸绮. Etchback effect analysis of Plasma on the PI. 2009 春季国际 PCB 技术/信息论坛,2009,10,上海
- (162) 张宣东 赵丽 陈国辉 周国云 莫芸绮 何波 何为. Research on Testing Method of the Gold-plated Layer Microporosity for PCB. 2009 春季国际 PCB 技术/信息论坛,2009,10,上海
- (163) 倪乾峰,袁正希,莫芸绮,何为,何波,陈浪,王淞. 应用于刚挠印制板无铅工艺兼容的不流动性半固化片.印制电路信息, 2009, 1 : 32~34
- (164) 刘尊奇,张胜涛,何为,莫芸绮,何波,陈浪,林均秀. 液晶电视用新型高性能 COF 基材的开发与测试. 印制电路信息, 2009, 2 : 38~41
- (165) 张宣东,吴向好,林均秀,徐玉珊,万永东,赵丽,何为. HDI 刚挠印制板中的埋盲孔工艺研究.印制电路信息, 2009, 3 : 26~29
- (166) 吴向好,陈国辉,何波,何为,赵丽,周国云. 激光微孔加工技术在刚挠性基材中的研究.印制电路信息, 2009, 3 : 30~34
- (167) 杨颖,王守绪,何为,王艳艳,吴向好,林均秀,徐玉珊,万永东,何波. 金属粉末-聚合物复合导电胶研究进展. 印制电路信息, 2009, 3 : 65~70
- (168) 周国云,何为,王守绪,刘尊奇,王淞,莫芸绮,陈浪,何波. 含丙烯酸胶膜刚挠结合板钻通孔试验及其机理研究.

印制电路信息, 2009, 6: 38~42

- (169) 刘尊奇, 张胜涛, 何为, 周国云, 倪乾峰, 金轶, 莫芸绮, 何波, 陈浪, 王淞, 林均秀. 层压法制作喷墨打印机墨盒的悬空引线. 电子电路与贴装. 2009 年第 3 期
- (170) 刘尊奇, 张胜涛, 何为, 莫芸绮, 周国云, 倪乾峰, 金轶, 何波, 陈浪, 王淞, 林均秀. 片式减成法 30 μ m/25 μ m(线宽/间距)COF 精细线路的制作. 印制电路信息. 2009, 8
- (171) 金轶, 何为, 周国云, 王守绪, 莫芸绮, 陈浪, 王淞, 何波. 等离子蚀刻挠性 PI 基材制作悬空引线及其参数优化. 印制电路信息. 2009, 8
- (172) 倪乾峰, 袁正希, 何为, 莫芸绮, 陈浪, 王淞. 等离子体清洁金手指表面的研究. 印制电路信息. 2009, 8
- (173) 张宣东, 莫芸绮, 何为, 吴向好, 何波. 用 Roll to Roll 生产工艺研制精细线路. 印制电路资讯. 2009, No.3
- (174) 张宣东, 赵丽, 陈国辉, 周国云, 莫芸绮, 何波. PCB 镀金层孔隙率检验方法研究. 印制电路信息, 2009(9): 27-30
- (175) 刘尊奇, 张胜涛, 何为, 莫芸绮, 周国云, 倪乾峰, 金轶, 何波, 陈浪, 王淞, 林均秀. RTR(Roll to Roll)方式制作 25 μ m /25 μ m COF 精细线路的参数优化. 印制电路信息, 2009(9): 41-45
- (176) 何为, 王守绪, 胡可, 何波, 汪洋. 挠性 PI 基材上镂空板用开窗口工艺研究. 电子科技大学学报, 2009, 38(5): 725-729 (EI: 20094512433466)
- (177) 袁正希, 倪乾峰, 袁世通, 何为. Study of PCB bonding finger surface discoloration. 电子科技大学学报, 2009, 38(5): 721-724 (EI: 20094512433465)
- (178) Ying Yang, Wei He, Shouxu Wang, Ke Hu, Bo He, Yunqi Mo. Ultra-fine Silver-plated Copper Powder Prepared by Ball Milling. 第二届先进材料亚洲研讨会, 2009, 10, 上海
- (179) 何为, 杨颖, 王守绪, 何波, 胡可. 导电油墨制备技术及应用进展. 材料导报. 2009, 23(11): 30-33
- (180) 周国云, 何为, 王守绪, 何波, 王淞, 莫芸绮. 六层刚挠结合板通孔等离子清洗研究. 印制电路信息(增刊, 中日印制电路秋季大会) 2009, 10, 深圳
- (181) 何为, 杨颖, 王守绪, 胡可, 何波. 导电油墨制备技术及应用进展. 材料导报, 2009, 23(11): 30-34
- (182) 杨小健, 何为, 王守绪, 杨颖, 胡可, 何波, 莫芸绮. 用喷墨打印的方式直接形成铜导电路图形. 印制电路信息, 2009(11): 28-32
- (183) 倪乾峰, 袁正希, 莫芸绮, 何为, 何波, 陈浪, 王淞. 等离子体凹蚀因素交互作用分析. 印制电路信息, 2009(11): 41-44
- (184) Yang Ying, Wang Shou-Xu, He Wei, Hu Ke, He Bo, Mo Yun-Qi. Synthesis of monodisperse ultra-fine copper powder in polyol. 2009 第八届中国国际纳米科技(湘潭)会议, 2009, 10(湘潭)
- (185) 薛卫东, 何为, 王守绪, 陈兆霞, 张敏, 陈浪, 何波, 万永东. 均匀设计法在等离子体去钻污工艺优化中的应用. 实验科学与技术. 2010, 8(2): 35-38
- (186) 何为, 吴婧, 夏建飞, 张敏, 王守绪, 胡可, 毛继美. 优化试验设计在次亚磷酸钠化学镀铜工艺研究中的应用. 实验科学与技术. 2010, 8(2): 39-42
- (187) 周国云, 何为, 王守绪, 莫芸绮, 毛继美, 陈浪, 何波. 等离子对刚挠结合印制板用材料蚀刻的均匀性及其机理研究, 2010 中日电子电路春季国际 PCB 技术/信息论坛 -2010, 深圳(大会报告, 大会优秀论文)
- (188) 陈苑明, 何为, 龙发明等. 纸基 RFID 标签天线印刷工艺参数的优化试验. CPCA 电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛. 上海: 印制电路信息杂志社, 2010(大会报告, 大会优秀论文)
- (189) 龙发明, 何为, 徐玉珊. 移动设备用光电刚挠印制电路板的制作及其可靠性研究. 印制电路信息, 2010(6): 61-64
- (190) 杨颖, 何为, 王守绪, 陈苑明, 胡可. 环氧树脂—银粉复合导电银浆的制备. 电子元件与材料, 2010, 29(5): 54-56
- (191) 龙发明, 何为, 王守绪, 周国云, 陈浪, 莫芸绮, 何波. 挠性板用高分子厚膜替代孔技术研究. 印制电路信息, 2010(8): 53-56
- (192) 王艳艳, 何为, 王守绪, 周国云, 陈浪, 林均秀, 莫芸绮. 平板显示器中应用 ACF 的驱动 IC 封装技术. 印制电路信息, 2010(8): 60-62

- (193) 陈苑明, 何为, 何雪梅, 莫芸绮, 周华, 徐玉珊, 何波. 导电银浆 RFID 天线过桥连接的可靠性研究. 包装工程. 2010, 31(15): 43-47
- (194) 余小飞, 何为, 王守绪, 唐裕, 张敏, 胡可, 毛继美. 一种用于导电油墨的特种铜粉制备研究. 2010 中日秋季国际 PCB 技术/信息论坛 -2010, 深圳
- (195) 吴婧, 何为, 王守绪, 夏建飞. 次亚磷酸钠作还原剂化学镀铜工艺研究. 2010 中日电子电路秋季国际 PCB 技术/信息论坛 -2010, 深圳
- (196) 龙发明, 何为, 陈苑明等. HDI 刚挠结合板微埋盲孔研究进展. CPCA 电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛. 深圳: 印制电路信息杂志社, 2010(大会报告, 大会优秀论文)
- (197) 林均秀, 陈国辉, 王艳艳, 何为. 超声波在 FPC 黑孔化工艺中的应用研究. 印制电路信息, 2010(9): 31-33
- (198) 陈苑明, 何为, 陈国辉. 应用 LCP 基材低成本化挠性 RF 电子元器件与天线. 印制电路信息, 2010(9): 37-40
- (199) 徐玉珊, 毛继美, 陈苑明, 何为. FPC 数控钻通孔的工艺研究. 印制电路信息, 2010(10): 28-30
- (200) 白亚旭, 袁正希, 何为, 唐柏云等. 等离子印刷与电金属化相结合——一种经济成本较好的 FPC 制造新技术. 印制电路信息, 2010(10): 33-38
- (201) 白亚旭, 袁正西, 何为, 何波, 莫芸绮. 溅射反应制备用于埋嵌无源电阻器的 TaN 薄膜电阻率的控制. 印制电路信息, 2010(12): 55-58
- (202) 刘江华, 陈宏勋, 莫芸绮, 徐玉珊, 陈苑明. ENIG 焊盘焊接工艺的优化. 全国第四届全国青年印制电路学术年会, 2010.11(成都)
- (203) 陈国辉, 方绍逵, 徐玉珊, 林均秀, 龙发明. PCB 黑孔工艺孔破原因分析. 全国第四届全国青年印制电路学术年会, 2010.11(成都)
- (204) 徐玉珊, 王淞, 王艳艳. Roll to Roll 生产工艺在天线 FPC 中的应用. 全国第四届全国青年印制电路学术年会, 2010.11(成都)
- (205) 毛继美, 徐玉珊. 异型冲孔机在 FPC 制造中的应用. 全国第四届全国青年印制电路学术年会, 2010.11(成都)
- (206) 何为, 薛卫东, 王守绪, 周国云. 应用于 COF 的无胶基材尺寸稳定性研究. 电子电路与贴装, 2010(3): 12-14
- (207) 白亚旭, 袁正希, 何为, 莫芸绮, 何波. PCB 基材上化学镀 Ni-P 合金层用于埋置电阻的工艺方法研究, 印制电路信息, 2011(1): 57-60
- (208) 龙发明, 何为, 徐玉珊等. 印制电路板中微埋盲孔研究进展. 世界科技与发展, 2010, 6: 749-751
- (209) 周华, 陈苑明, 何为, 等. 键盘式薄膜开关的制造工艺研究. 电子元件与材料, 2011, 2
- (210) 何雪梅, 何为, 陈苑明, 毛继美, 刘炜华, 周华, 莫芸绮. Roll to Roll 丝网印刷 RFID 天线的工艺优化研究. CPCA 2011 春季国际 PCB 技术/信息论坛, 上海, 2011.3(大会报告)
- (211) 余小飞, 何为, 王守绪, 陆彦辉, 周国云, 胡可, 何波, 莫芸绮. UV 激光加工盲孔的工艺研究. CPCA 2011 春季国际 PCB 技术/信息论坛, 上海, 2011.3(大会报告)
- (212) 白亚旭, 袁正希, 何为, 莫芸绮, 何波. 丝网印刷导电碳浆法制备埋置电阻——电阻层厚度控制的研究. 印制电路信息, 2011(6): 49-51
- (213) 王艳艳, 何为, 周国云, 陈苑明, 何波, 莫芸绮, 周华. 减层法制作双面板 COF 印制板工艺研究. 印制电路信息. 2011, (5): 1-20
- (214) 吴婧, 王守绪, 何为, 胡可. 亚铁氰化钾添加于次亚磷酸钠还原化学镀铜的实验优化. 印制电路信息. 2011, (5): 26-30
- (215) 张敏, 胡文成, 何为. 印制电路组件用高导热有机硅灌封料的研究. 印制电路信息. 2011, (5): 58-60
- (216) 杨小健, 何为, 王守绪, 周国云. 导电油墨复合材料的制备及性能研究. 科学技术与工程. Vol. 11(16): 3703-3708
- (217) 白亚旭, 袁正希, 何为, 莫芸绮, 何波, 周华. 丝网印刷导电碳浆法制备埋置电阻——电阻层厚度控制的研究(1). 印制电路信息. 2011, (6): 49-52
- (218) 白亚旭, 袁正希, 何为, 莫芸绮, 何波, 周华. 丝网印刷导电碳浆法制备埋置电阻——电阻层厚度控制的研究(2). 印制电路信息. 2011, (7): 34-36

- (219) 余小飞, 何为, 周国云, 王守绪, 莫芸绮, 王淞, 何波.一种盲孔评估的新方法.印制电路信息.2011,(7) : 45-47
- (220) 莫芸绮、王淞、毛继美、何为、陈苑明.基于制作 COF 精细线路的液态光致抗蚀液性能研究.印制电路信息.2011(8) : 31 - 34
- (221) 胡有作、薛卫东、何为、黄雨新、吕文驱、罗旭、刘振华、李启军.用正交试验法优化挠性单面板精细线路的工艺.印制电路信息.2012(1):49-52
- (222) 陈世金、黄雨新、罗旭.龙门式电镀生产 75 μ m/75 μ m 线镀铜均匀性研究.印制电路信息.2012(1):34-41
- (223) 黄雨新、何为、胡有作、徐缓、覃新、罗旭.酸性 CuCl₂ 蚀刻均与性与蚀刻速率研究. 印制电路信息.2012(2):38-41
- (224) 胡友作 何为 薛卫东 黄雨新 徐缓 吕文驱 罗旭. CO₂ 激光钻挠性板盲孔工艺参数的优化(Optimized the parameters of CO₂- laser during drilling blind-vias of PCB).2012 春季国际 PCB 技术/信息论坛会, 上海, 2012.3
- (225) 黄雨新 何为 胡友作徐缓 覃新 罗旭 陈世金 王科成.激光在印制电路板制造中应用的新进展(New Advances of Laser Application for PCB Manufacturing).2012 春季国际 PCB 技术/信息论坛会, 上海, 2012.3
- (226) 冯立 何为 黄雨新 何杰 徐缓 周华 罗旭 戴冠军.Study on the Influence Factors of Middle Hole-shift for PCB Lamination.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2012.11 Guangdong, Dongguan.
- (227) 胡友作,何为,薛卫东,黄雨新,徐缓. 冷热冲击下 BGA 焊接失效的分析研究. 电子元件与材料, 2012, 31(5) : 63-65
- (228) 何杰 何为 黄雨新 冯立徐缓 周华 罗旭 戴冠军. 正交试验法对 50 μ m/50 μ m 精细线路制作工艺参数的优化. 印制电路信息.2013(3):31-34
- (229) 何杰 何为 黄雨新 冯立, 徐缓 周华 罗旭 戴冠军.半固化片直接塞埋孔工艺研究. 2013 春季国际 PCB 技术/信息论坛.2013.3 上海.
- (230) 冯立, 何为, 何杰, 黄雨新, 徐缓, 周华, 郭茂桂, 王娇龙.均匀设计法在优化挠性双面板快压覆盖膜工艺参数中的应用, 印制电路信息.2013(5):46-50
- (231) 何杰,何为,冯立,黄雨新 徐缓 周华 罗旭.HDI 板分层原因研究及解决方案,印制电路信息.2013(2):3942
- (232) 朱凯 何为 陈苑明 陶志华陈世金 徐缓 .提高电镀填盲孔效果的研究.2013 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2013,11,20, 广东东莞(大会报告)
- (233) 李晓蔚 陈际达 徐缓 陈世金 郭茂桂 何为 冯立 江俊锋. 单纯型优化法在 CO₂ 激光钻盲孔工艺参数中的应用研究. 2013 秋季国际 PCB 技术/信息论坛 广东东莞 2013.11.20:110-115
- (234) 何杰 何为 陶志华 冯立徐缓 周华 李志丹 郭茂贵.孔、线共镀铜工艺的研究与优化.2013 秋季国际 PCB 技术/信息论坛 广东东莞 2013.11.20:70-75
- (235) 陈际达 刘又畅 李晓蔚 张胜涛 晏放雄 周强村 徐缓 陈世金何为 覆铜板生产设备创新与改进. 2013 秋季国际 PCB 技术/信息论坛 广东东莞 2013.11.20:6-10
- (236) 何杰 1, 何为 1, 陈苑明 1, 冯立 1, 徐缓 2, 周华 2, 郭茂桂 2, 李志丹 2. 印制电路板孔线共镀铜工艺研究. 电镀与精饰.2013, Vol 35(12):27-31
- (237) 冯立,何为,黄雨新,何杰,徐缓. 改善印制电路板化学镀镍耐蚀性的研究进展.电镀与涂饰, 2013,32(9) : 39-42
- (238) 于岩, 朱彦俊, 王守绪, 何为, 徐缓. 不同叠层结构印制电路板散热性能研究. 电子元件与材料.2014, Vol.33(1):43-47
- (239) 江俊锋, 何为 冯立, 刘振华, 郭茂桂, 王蛟龙.影响挠性板黑孔化工艺效果的因素探究.印制电路信息.2014(8):58-61
- (240) 杨婷 何为 成丽娟 周国云 徐缓.HDI 印制电路板中的激光钻孔工艺研究及应用, 印制电路信息.2014(4):210-214

- (241) 江俊锋 何为 冯立陈世金 周华.半加成法制作 30 μ m/30 μ m 精细线路及其工艺优化.印制电路信息, 2014(3) : 36-39
- (242) 江俊锋, 何为, 周华, 陈苑明, 陈世金, 邓宏喜.一种对称型刚挠结合板的制作方法.2014 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 广东东莞,2014.11.19-20.
- (243) 刘佳, 陈际达, 邓宏喜, 陈世金, 郭茂桂, 何为, 江俊峰.通孔电镀填充工艺研究与优化.2014 中日电子电路春节大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 广上海,2015.3.17-19.
- (244) 江俊锋, 何为, 陈苑明, 何彭, 陈世金, 郭茂桂, 刘振华, 谭泽.影响 PCB 镀镍层厚度和均匀性的因素及工艺优化.电镀与精饰, 2015, 37(1) : 5-9
- (245) 陈世金 徐 缓 邓宏喜 何为 李松松.电镀填 盲孔薄面铜化技术研究, 印制电路信息, 2015(5) : 44-47
- (246) 陈世金、黄干宏、黄李海、胡志强、何为.不同前处理磨板对对板材涨缩影响研究, 2016 春季国际 PCB 技术/信息论坛论文集, 2016 年 3 月 16, 上海.16-26
- (247) 文娜, 何为, 王守绪, 周国云 黄继茂, 周先文, 王瑜, 徐缓.高频印制电路铜面平整化修饰技术的研究, 2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集, 2016 年 11 月 3 日, 广东东莞(大会报告).
- (248) Yao Tang, Wei He, Guoyun Zhou, Shouxu Wang, Xiaojian Yang,Zhijia Tao and Juncheng Zhou. A new approach causing the patterns fabricated by silver nanoparticles to be conductive without sintering. Nanotechnology, VOL23 (2012)
- (249) 陆彦辉 何为 周国云 陈苑明 赵丽; 付红志; 刘哲; 高频高速印制板材料导热性能的研究进展.印制电路信息, 2011(12) : 15-19.
- (250) 周珺成 何为 陈苑明 周国云 王守绪.有限元分析导热层厚度对印制电路散热性能影响.(Finite Element Analysis on the Effect of Heat Conduction Layer Thickness on Heat Dissipation Capability of PCB).2012 春季国际 PCB 技术/信息论坛会, 上海, 2012.3
- (251) 杨小健,何为,王守绪,等 .用喷墨打印法直接形成铜导电路图形 .印制电路信息, 2009 ,(11) :28-31
- (252) 杨小健, 何为, 王守绪, 等 . 导电油墨复合材料的制备及性能研究 . 科学技术与工程, 2011, (11) : 3703-3708
- (253) 杨小健,何为,王守绪,等 .石墨/环氧树脂导电油墨复合材料的制备及性能研究 .材料导报,2011 ,(25) : 20-23
- (254) 10 杨小健,何为,王守绪,等. 石墨\炭黑\改性树脂导电复合材料的电学性能研究.化工新型材料, 2012, 40(2): 91-94
- (255) 周珺成, 何为, 周国云, 王守绪.PCB 盲孔镀铜填充添加剂研究进展.印制电路信息, 2012(7) : 35-39.
- (256) Xiaojian Yang, Wei He, Shouxu Wang, Guoyun Zhou, Yao Tang. Preparation of High-Performance Conductive Ink with Silver Nanoparticles and Nanoplates for Fabricating Conductive Films. Materials and Manufacturing Processes., 28: 1-4, 2013
- (257) 唐耀, 陶志华, 王守绪, 何为.A New Approach of Printing Conductive Patterns with Silver Nanoparticles without Sintering.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2012.11 Guangdong ,Dongguan.
- (258) 陈苑明, 何为, 杨颖, 王守绪, 陶志华, 汪洋, 罗道军.Thermal Effects of PCB laminates in Dynamic Temperature.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术 / 信息论坛 , 2012.11 Guangdong ,Dongguan.
- (259) 周峰, 王守绪, 何为, 张海泉.Copper-doped Phenolic Resin Conductive Ink.2012 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛, 2012.11 Guangdong ,Dongguan.
- (260) 曹洪银, 唐耀, 王守绪, 何为, 毛英捷.自还原体系银导电墨水的制备与低温印制导电图形的研究.2013 春季国际 PCB 技术/信息论坛.2013.3 上海(大会报告)
- (261) 周峰, 王守绪, 何为, 唐耀, 陈苑明.PCB 金相分析抛磨夜的研究.实验科学与技术.2012, 10(6) : 18-21
- (262) 林建辉, 王翀, 陶志华, 王守绪, 何为.纳米银材料的化学制备及其在 PCB 中的应用.印制电路信息, 2013(12) :

- (263) 周国云,何为,王守绪.印制板中炭黑类埋置电阻喷墨打印油墨的制作及性能研究.印制电路信息,2014(3): 13-16
- (264) 江俊锋,何为,冯立,陈世金,周华.半加成法制作 30 μ m/30 μ m 精细线路及其工艺优化.印制电路信息, 2014(3): 36-39
- (265) 洪敦华;周国云;何为;王守绪.银-DBSA 掺杂聚苯胺的制备及应用研究.印制电路信息,2014(6):45-49
- (266) 王守绪,胡永栓,何雪梅,董颖韬,苏新虹,何为.UV 激光控深铣技术在刚挠结合印制电路板中的应用研究.印制电路信息,2015(6)
- (267) 王守绪,胡永栓,苏新虹,周国云,董颖韬,何为.嵌入挠性线路印制电路板中埋入挠性基板区尺寸研究.印制电路信息,2015(6)
- (268) 冀林仙,王翀,王守绪,何为.数字模拟在应用电化学课程教学中的应用.化学教育,2015,36(14):16-20
- (269) 58.冀林仙,王翀,王守绪,1.陈国琴,肖定军,何为.添加剂对微盲孔铜沉积的影响研究.2015 中日电子电路秋季大会,广东东莞,2015,11
- (270) 59.杨婷,何为,胡永栓,苏新虹,胡新星,史书汉.超高层数的背板制作中厚板压合过程的影响因素研究.2015 春季国际 PCB 技术/信息论坛,2015,3,上海
- (271) 60.向静,陈苑明,何为,陈先明,宝玥.电镀前处理对电镀铜柱均匀性改善的研究.2015 春季国际 PCB 技术/信息论坛,2015,3,上海
- (272) 彭佳,程骄,梁坤,王翀,何为.高密度互连通孔填孔电镀铜工艺研究,2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集,2016 年 11 月 3 日,广东东莞(大会报告).
- (273) 赖志强,程骄,王翀,肖定军,何为.对流方式和整平剂协同作用对 PCB 通孔深镀能力的影响研究,2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集,2016 年 11 月 3 日,广东东莞(大会报告).
- (274) 毛英捷,何为,王守绪,周国云,陈苑明,苏新虹,胡永栓,胡新星,吴世平.印制电路板铜面处理工艺对高频信号传输的影响研究,2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集,2016 年 11 月 3 日,广东东莞(大会报告).
- (275) 文娜,何为,王守绪,周国云,黄继茂,周先文,王瑜,徐缓.高频印制电路铜面平整化修饰技术的研究,2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集,2016 年 11 月 3 日,广东东莞(大会报告).
- (276) 林建辉,梁坤,杨文君,王守绪,刘彬云,何为.乙醛酸活化铜线路实现无钯 ENIG 的可行性研究,2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集,2016 年 11 月 3 日,广东东莞(大会报告).
- (277) 彭佳,王翀,何为等.PCB 电镀铜添加剂作用机理研究进展(电镀与精饰接收,暂未发表)
- (278) 陈苑明,何雪梅,张怀武,何为,王守绪,胡永栓,苏新虹,李晓.大数据服务器用盲孔压接背板塞孔互连的研究.2016 年全国博士后学术论坛:大数据时代下新型智慧城市及全球展望,2016:375-384.
- (279) 陶志华,何为.PCB 酸铜填孔电镀添加剂协同机制研究(电子科学与信息技术创新发展 2016 年全国博士后学术论坛)
- (280) 陈苑明,何为,Vadim Silberschmidt.片状堆积多孔氧化铜颗粒的合成、表征及其在高性能填铜中的应用,Taiwan Printed Circuit Association,2014,5,苏州,中国.
- (281) 陈国琴,王翀,王守绪,何为,,肖定军,谭泽.PCB 电镀铜镀液中铁离子对镀层质量的影响研究.2014 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛,广东东莞,2014.11.19-20.
- (282) 彭佳,何为,王翀,陈世金,肖定军,谭泽.添加剂之间的交互作用对盲孔填充的影响.印制电路信息,2014(9):
- (283) 彭佳,何为,王翀,肖定军,谭泽.采用试验设计法研究 HDI 板盲孔填充影响因素.印制电路信息,2014(12): 23-26
- (284) 朱凯,王翀,何为,程骄,肖定军.一种快速填盲孔的工艺及原理研究.2014 中日电子电路春节大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛,上海,2015 年 3 月 17-19
- (285) 陶志华,何为,王守绪,周国云,肖定军,谭泽.铜在电镀液中的腐蚀电化学行为.中国科技论文在线,2015,10(12):1382-1386 Yuanming Chen, Shouxu Wang, Xuemei He, Wei He, Vadim V. Silberschmidt, Ze Tan. Copper coin-embedded printed circuit board for heat dissipation: manufacture, thermal simulation and reliability. Circuit World, 2015, 41(2): 55-60.

- (286) 陈杨, 程骄, 王翀, 何为, 朱凯, 肖定军.高电流密度通孔电镀铜影响因素的研究.电镀与精饰, 2015(已录用).
- (287) 向琳, 王翀, 陈苑明, 王守绪, 肖定军, 何为. 含咪唑基、巯基的印制线路板新型棕化[C].四川省电子学会半导体与集成技术专委会 2014 年度学会论文集, 2014,
- (288) 江俊锋, 何为, 陈苑明, 何彭, 陈世金, 郭茂桂, 刘振华, 谭泽.影响 PCB 镀镍层厚度和均匀性的因素及工艺优化.电镀与精饰, 2015, 37(1): 5-9
- (289) 王胜广, 何为, 王翀, 王守绪, 谭泽.亚硫酸钠还原法制备氧化亚铜.广州化工, 2016, 44(2): 44-46.
- (290) 张毅, 何为, 王翀, 王守绪, 谭泽.硫醇对去除镍粉表面吸附无机阴离子的研究.广州化工, 2016, 44(2):88-90
- (291) 冀林仙,王翀,王守绪 1 陈国琴,肖定军,何为. 添加剂对微盲孔铜沉积的影响研究. 2015 中日电子电路秋季大会,广东东莞, 2015,11
- (292) 李玖娟; 何为; 王守绪; 周国云; 谭泽.PEG 液相体系制备纳米铜颗粒的研究.电 子 元 件 与 材 料, 2015,34(12): 27-30
- (293) 王胜广, 何为, 谭泽等. 电解法制备氧化亚铜及其稳定性研究[J].广州化工, 2016, 44(04): 29-31.
- (294) 赖志强、王翀、何为、程娇、肖定军. 高温高速通孔电镀铜工艺优化, 2016 春季国际 PCB 技术/信息论坛论文集, 2016 年 3 月 16, 上海.82-88
- (295) 彭佳, 程骄, 梁坤, 王翀, 何为. 高密度互连通孔填孔电镀铜工艺研究, 2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集, 2016 年 11 月 3 日, 广东东莞(大会报告).
- (296) 赖志强,程骄,王翀,肖定军,何为. 对流方式和整平剂协同作用对 PCB 通孔深镀能力的影响研究,2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集, 2016 年 11 月 3 日, 广东东莞(大会报告).
- (297) 林建辉, 梁坤, 杨文君, 王守绪, 刘彬云, 何为.乙醛酸活化铜线路实现无钯 ENIG 的可行性研究, 2016 秋季国际 PCB 技术/信息论坛论文集, 2016 年 11 月 3 日, 广东东莞(大会报告).
- (298) 何琳, 谭泽, 陈苑明, 何为. 封装基板叠层互连电镀铜的均匀性研究. 重 庆 师 范 大 学 学 报(自然科学版), 2016,33(4): 127-133